




Kinetic MCU

業界で最も拡張性のあるARM® Cortex™-M4 MCUのポートフォリオ!



- 技術解説 | 製品解剖 | ニューテクノロジー | インタビュー | ニュース解説 | 記事一覧 | ブックレット | メルマガ

▼ EDN Japan ▼ @IT MONOist ▼ イベント/展示会 ▶ EE Times×EDN電子版

▼ テーマサイト ▼ パワー&エネルギー **NEW** ▼ Wireless **NEW** ▼ モーションセンシング ▶ 無線LAN技術 **NEW** ▶ FPGA ▶ 車載ソフト開発

EE Times Japan > 無線通信技術 LTE: 次に狙うはLTE, Insight SiPが...

2012年05月16日 14時58分 UPDATE

無線通信技術 LTE:

次に狙うはLTE, Insight SiPが小型無線モジュールの提供を2013年初頭に予定

無線通信モジュール/SiPを手掛けるInsight SiPは、特定の顧客を対象に、LTEに対応するデモ用フロントエンドモジュールの紹介を始めた。2012年末~2013年初頭には最終製品への搭載を想定した小型品のサンプル提供を開始する予定である。

[前川慎光, EE Times Japan]

Tweet | J'aime | +1 | チェック | 共有する | プリント/アラート

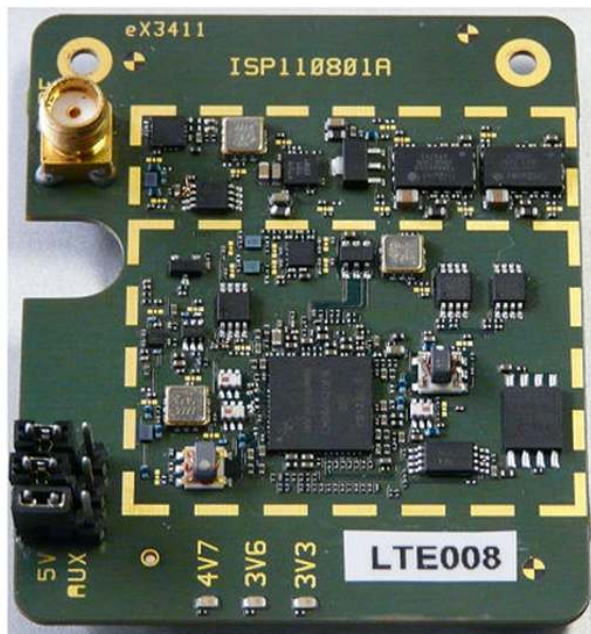
無線通信モジュールやSiP(System in Package)の設計開発を手掛けるフランスのInsight SiPは、携帯電話の最新通信規格「LTE(Long Term Evolution)」のフロントエンドモジュール(FEM)の提案を始めた。LTE対応のRFトランシーバICやパワーアンプ(PA)、低雑音アンプ(LNA)、フィルタをまとめたもの。

同社はこれまで、低消費電力の近距離無線通信規格「Bluetooth Low Energy(BLE)」や、ハイビジョン映像の無線伝送用の「WHDI(Wireless Home Digital Interface)」に対応したモジュールの設計情報を提供してきたが、LTEの市場拡大を見込み、ピコセルやフェムトセルベンダーにFEMを売り込む(関連記事)。現在は特定の顧客にデモ用モジュールを提供している段階だが、2012年末~2013年初頭には、最終製品への搭載を想定した小型モジュールのサンプル出荷を始める予定である。



世界最高レベルの 効率と信頼性を誇る LED ドライバ IC

▶ 詳細を表示... ビデオを見る



Insight SiPのデモ用LTEモジュール 2012年末~2013年初頭には、最終製品への搭載に向けたさらなる小型のモジュールを用意し、サンプル提供を始

○ スポンサーからのお知らせ - PR -

■ 10分の動画で効率よく学ぶ! ビデオ・レクチャ電源、データコンバータ、無線、環境発電までリニアテクノロジーのハイエンドアナログ製品

○ ニュースヘッドライン

- 次に狙うはLTE, Insight SiPが小型無線モジュールの提供を2013年初頭に予定(2012年5月16日)
- 100億個規模のCPUコア市場、ARMが独占状態(2012年5月16日)
- 【M2M展2012】ビッグデータが「場」となる、それを有機的に活用するのがM2Mだ(2012年5月16日)
- マイコンの進化を不揮発メモリが助ける、パナソニックが「ReRAM」を採用(2012年5月15日)
- いよいよ無線も1Gビット/秒超へ、バッファローが業界初の「11ac」製品の販売を開始(2012年5月15日)

○ Special Site - PR -

- 流体解析** 設計に役立つ流体解析とは? 基礎~応用まで電子機器や自動車の開発事例を多数掲載!
- Xtrem FPGA** FPGA / DSP / 組み込みシステム設計者必見のグローバル技術トレーニング **New!**
- 電子回路設計のヒント集** 組み込み/アナログ半導体技術の総合サイト 電子回路設計のヒント集 Tech & Info
- FPGA Insights** FPGAの総合情報サイト

○ Special Contents - PR -

- intel** 「インテリジェント・システム」とは何か? インテル・ブースで明らか!!【ESEC2012】
- Cartoon** CADマネジャー 藍さんのお仕事【第3話】 今晩中に200枚印刷! あなたならどうする? **New!**
- 設計解析** いすゞのエンジン部品開発で効果を発揮! SCRYU/Tetralによる解析を自動化 **New!**
- 電子回路設計のヒント集** USB3.0の本格普及を祝い、TIが相互接続性を高めた「HABIC」を製品化
- ルネサスユーザコミュニティ「かみえルネ」** ルネサスユーザー同士の技術的な交流サイト

PR

限りない選択肢の提供! 

www.digikey.jp

仕入先一覧表

新製品情報

Digi-Keyツールバー

既に提供を始めているBLE規格向けとWHDI規格向けのモジュールについても、ともに2012年に本格的に採用が始まると見込んでいる。「BLE規格向けの引き合いがここ最近、大幅に増えている。今はまだ最終製品の市場投入が始まった初期の段階だが、2012年末～2013年には市場が立ち上がるのではないかと。もう一方のWHDI規格については、今後ノートPCやタブレットPCへの内蔵が進むかどうかはチャレンジだろう」(Insight SiPのCEOを務めるMichel Beghin氏)という。

Insight SiPは、フランスのソフィア アンティポリスに本社を置くベンチャー企業で、2005年に設立された。「半導体ベンダーと機器メーカーのギャップをモジュールでつなぐ」をコンセプトに、無線通信モジュールやSiPの設計受託や設計開発を手掛けている(関連記事その1、関連記事その2)。高集積で小型の無線通信モジュール/SiPを設計する技術や、アンテナをモジュールに一体化させる技術に強みがあるという。



Insight SiPのCEOを務めるMichel Beghin氏